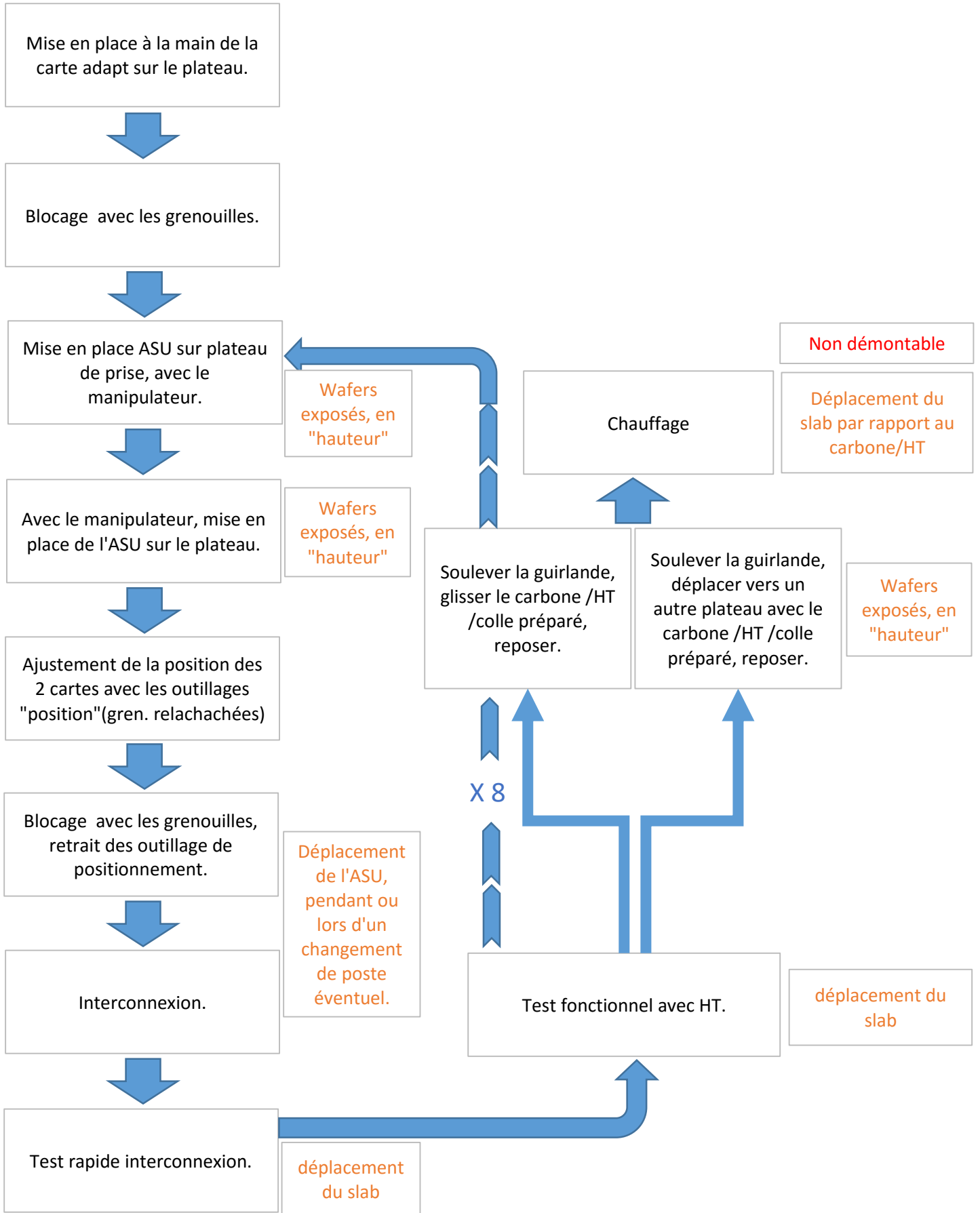
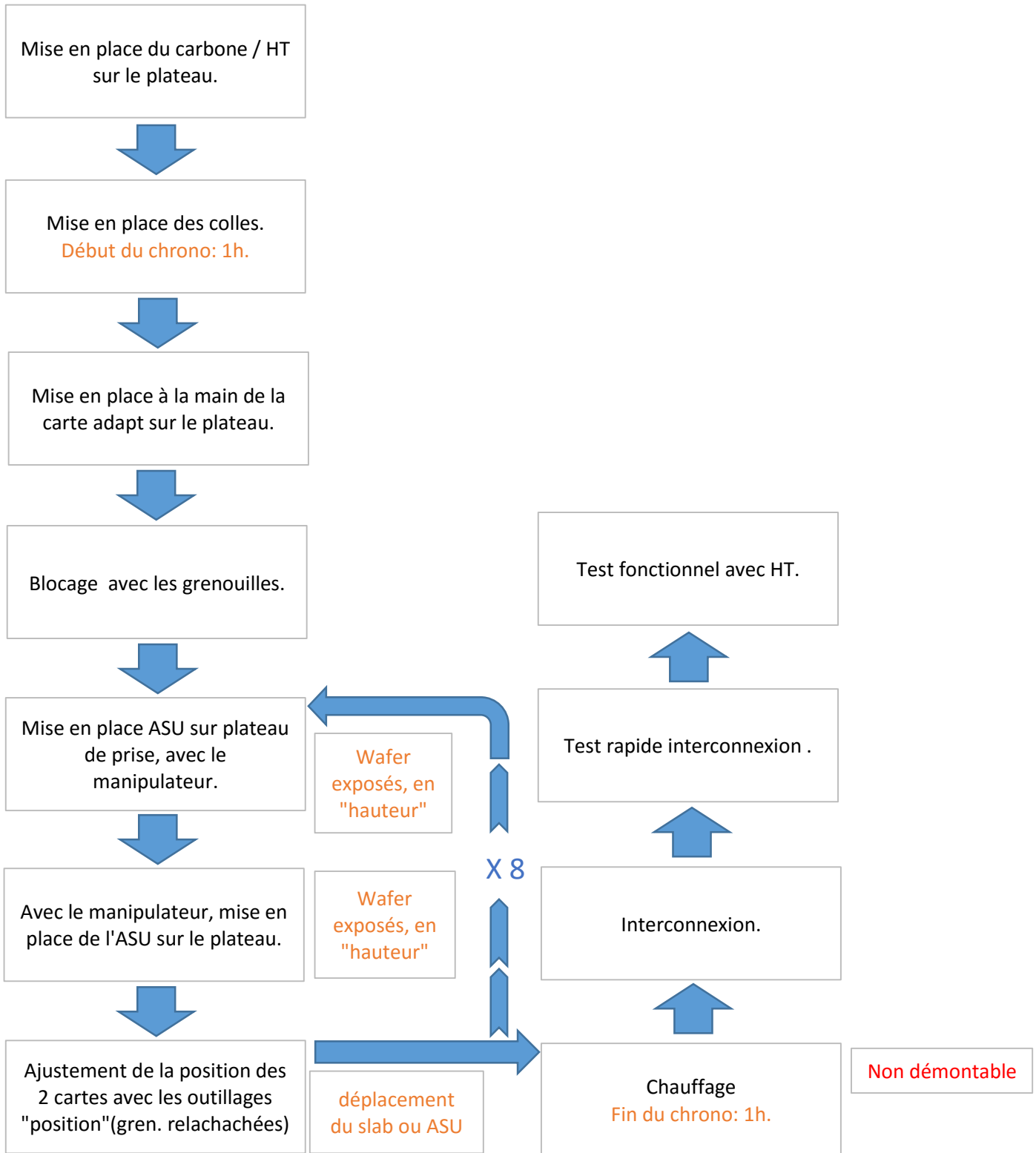


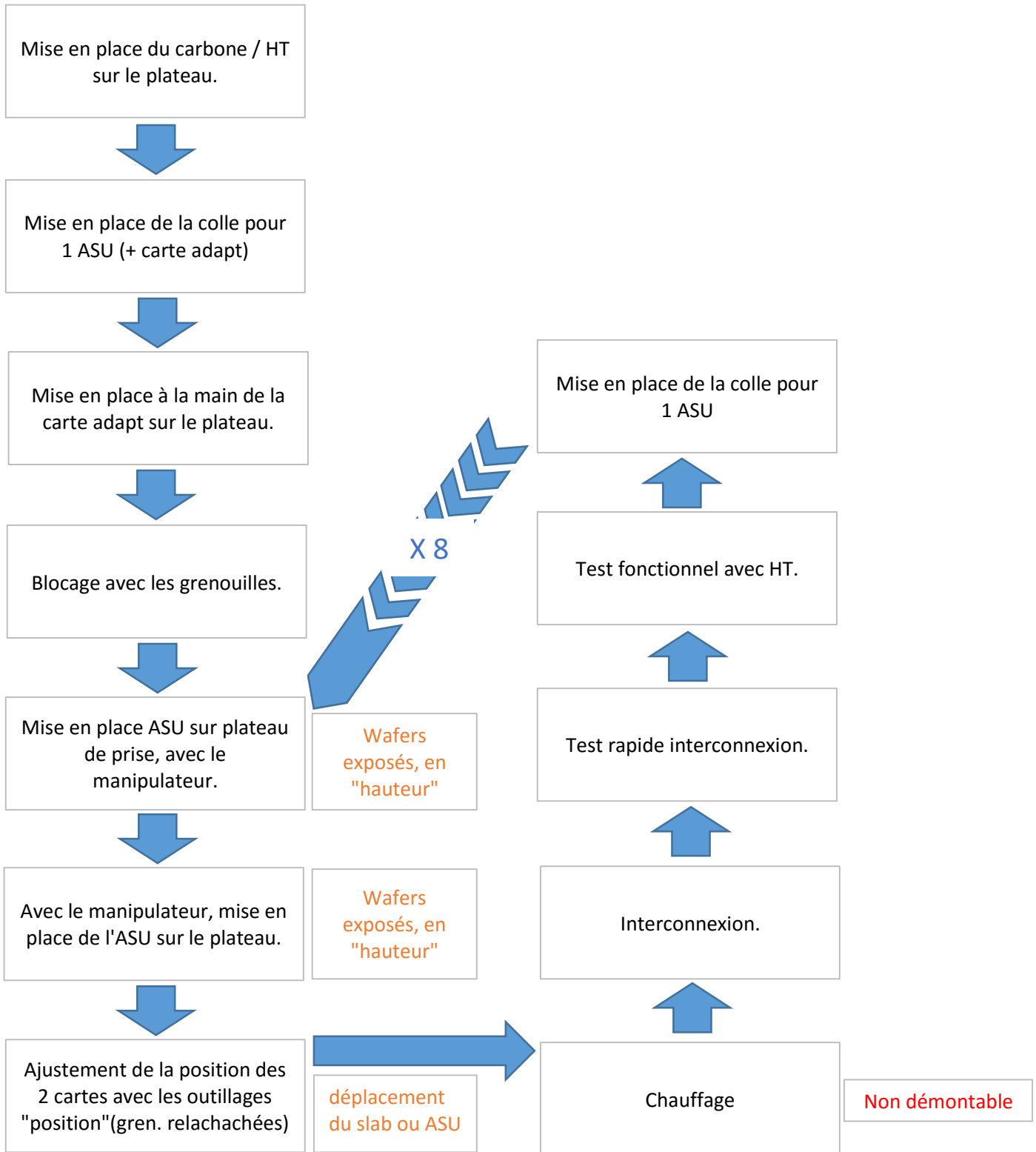
METHODE GUIRLANDE



METHODE SOLIDE



METHODE SEMI SOLIDE



Méthode Guirlande		Méthode solide		Méthode semi solide	
Avantages	inconvénients	Anvantages	inconvénients	Avantages	inconvénients
Possibilités d'échanger n'importe quel ASU en cours de montage	Manutention du slab entier (exposition des wafers) lors du collage	Minimum d'exposition des wafers	Aucune possibilité de changement d'ASU, même avant l'interconnexion	Minimum d'exposition des wafers	Pas de changement de(des) l'ASU précédent(s) déjà collé(s)
Adaptabilité de la longueur des slab	Nécessité d'un outillage pour toute manipulation (avant collage)	Manipulable à la main (après collage avant interconnexion)	Délai d'une heure max pour poser et positionner tous les ASU	Changement de l'ASU en cours de collage, délai une heure	Possibilité de manipuler à la main en cours de montage